

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2022-072

## 北京赛微电子股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	赛微电子	股票代码	300456
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张阿斌	刘波	
电话	010-82252103	010-82251527	
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼	
电子信箱	ir@smeiic.com	ir@smeiic.com	

#### 2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	377,431,827.16	394,837,209.69	-4.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,298,711.72	72,064,145.07	-88.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-61,880,531.59	-5,490,592.03	-1,027.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,734,652.91	-59,166,374.62	138.42%
基本每股收益（元/股）	0.0114	0.1128	-89.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0114	0.1128	-89.89%
加权平均净资产收益率	0.16%	2.37%	-2.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	6,712,902,871.25	7,239,642,304.26	-7.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,005,144,867.92	5,082,992,412.37	-1.53%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东 总数	61,689	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	持有特别表决 权股份的股东 总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨云春	境内自然人	26.82%	196,676,719	152,406,414	质押	150,000,016
国家集成电路产业投 资基金股份有限公司	国有法人	12.05%	88,362,101	0		
中泰证券资管—证券 行业支持民企发展中 泰资管 2 号 FOF 集 资管计划—证券行业 支持民企发展系列之 中泰资管 18 号单一 资产管理+	国有法人	5.00%	36,664,400	0		
中金期货有限公司— 中金期货—融汇 1 号 资产管理计划	境内非国有法人	1.06%	7,748,934	0		
香港中央结算有限公 司	境外法人	0.69%	5,087,155	0		
#杭州乐信投资管理有 限公司—乐信长阳私 募证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	4,947,153	0		
刘琼	境内自然人	0.66%	4,875,372	0		
中国银行股份有限公司— 国泰 CES 半导体 芯片行业交易型开放 式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	3,746,434	0		
国泰君安证券股份有 限公司—国联安中 证全指半导体产品与 设备交易型开放式指 数	境内非国有法人	0.51%	3,726,334	0		

证券投资基金					
李纪华	境内自然人	0.43%	3,141,623	0.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、中泰证券资管—证券行业支持民企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 18 号单一资产管理+、刘琼、李纪华之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	杭州乐信投资管理有限公司—乐信长阳私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,947,153 股，实际合计持有 4,947,153 股。				

公司是否具有表决权差异安排

是 否

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 一、整体经营情况

报告期内，公司半导体业务保持良好发展状态，尤其主营业务 MEMS（微机电系统）工艺开发与晶圆制造具备全球竞争优势，拥有业内顶级专家与工程师团队以及持续扩张的 8 英寸成熟产能，较好地把握了下游生物医药、通讯、工业汽车、消费电子等应用领域的市场机遇；其中瑞典 MEMS 产线的订单、生产与销售状况良好，在 COVID-19 疫情全球持续、国际地缘政治冲突的背景下，在本报告期内继续实现了业务增长，保持了良好的盈利能力（但由于瑞典克朗与人民币之间的汇率波动，导致瑞典 MEMS 产线实现的收入及利润按人民币折算的呈现结果为下降）。北京 FAB3 本报告期实现业务收入，但由于产线仍处于运营初期，代工晶圆中已实现量产的品类较少，大部分仍处于工艺开发、产品验证或风险试产阶段，产能爬坡较为缓慢，收入规模较小。由于客观上继续面临较大的折旧摊销压力，工厂运转及人员费用持续增长，叠加 COVID-19 疫情等外部因素，北京 MEMS 产线发生较大亏损，最终导致本报告期 MEMS 业务发生亏损。公司为把握市场机遇，继续增加半导体业务的资本投入和人员招聘，保障核心业务 MEMS 和潜力业务 GaN（氮化镓）的持续投入，本报告期内相关管理费用大幅增长，研发费用继续处于较高投入水平。另外，公司出售了部分参股子公司的股权，投资参与的半导体产业基金等处于回报期，综合贡献了投资收益。

报告期内，公司实现营业收入 37,743.18 万元，较上年同期下降 4.41%；实现营业利润-3,993.24 万元，较上年同期大幅下降 150.48%；实现利润总额-4,018.21 万元，较上年同期大幅下降 150.79%；实现净利润-3,580.68 万元，较上年同期大幅下降 176.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 829.87 万元，较上年同期大幅下降 88.48%；归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益的净利润-6,188.05 万元，较上年同期大幅下降 1,027.03%。报告期内，公司基本每股收益 0.0114 元，较上年同期下降 89.92%；加权平均净资产收益率 0.16%，较上年同期下降 2.21%（绝对数值变动），主要是由于归属于上市公司股东的净利润同比下降 88.48%。本报告期末，公司总资产 671,290.29 万元，较期初下降 7.28%；归属于上市公司股东的所有者权益 500,514.49 万元，股本 733,289,072.00 元，归属于上市公司股东的每股净资产 6.83 元，较期初基本持平。

此外，在非经常性损益方面，因公司报告期内出售部分参股公司股权、产业基金继续提供回报，公司合计取得长期股权投资处置收益 7,809.78 万元；公司主营业务活动陆续取得系列政府补助，其中部分补助在本报告期内补偿了部分相关成本费用或损失，公司取得补助收益 459.51 万元。

## 二、各主要业务情况

### （一）MEMS 业务保持发展韧性

报告期内，公司 MEMS 业务体现了较为充分的发展韧性。一方面，在欧洲普遍不再针对 COVID-19 疫情采取主动措施、突发俄罗斯-乌克兰战争的背景下，瑞典 FAB1&FAB2 产线仍按计划推动新增产能的磨合，持续调试产线以实现成熟运转，在 2022 年上半年继续实现了收入及利润的增长（瑞典克朗口径），且继续为下一步的业务增长奠定产能及工艺基础；另一方面，北京 FAB3 产线持续加大研发投入，自主积累基础工艺，积极探索各类 MEMS 器件的生产诀窍，但由于在报告期进入量产的品类较少，因此仅实现收入 3,643.92 万元，基于目前已覆盖的客户及产品类型，随着后续进入试产及量产阶段的产品品类增加，北京 FAB3 产线具备充足的发展潜力。

报告期内，公司 MEMS 业务整体继续保持高水平发展质量，2022 年上半年实现收入 35,763.41 万元，较上年下降 0.96%，其中，MEMS 晶圆制造实现收入 18,621.64 万元，较上年下降 26.93%，MEMS 工艺开发实现收入 17,141.77 万元，较上年增长 61.36%，上述变化的主要原因是：基于公司旗下不同中试线及量产线的定位，即瑞典 FAB1&FAB2 属于中试线+小批量生产线，北京 FAB3 和德国 FAB5（若该收购能够获批完成）均属于规模量产线，瑞典 FAB1&FAB2 产线在新增产能磨合释放前，突出的竞争优势及业务重点在于工艺开发业务，且工艺开发业务具有前置导入属性，需要基于瑞典产线及德国产线的新增产能做好更多储备。与此同时，由于北京 FAB3 仍处于运营初期，营收规模体量仍较小，且现阶段工艺开发业务的比重高于晶圆制造业务。因此，本报告期公司 MEMS 业务呈现晶圆制造业务收入下降、工艺开发业务收入大幅增长的状态。当然，假设相比去年同期剔除本报告期瑞典克朗与人民币之间的汇率波动影响，本报告期 MEMS 晶圆制造业务的收入降幅将显著收窄至下降 17.19%，MEMS 工艺开发业务的收入增幅将进一步扩大至增长 81.96%。

报告期内，公司 MEMS 业务的综合毛利率为 33.24%，较上年下降 13.95%，其中 MEMS 工艺开发毛利率为 51.70%，较上年下降 29.15%（绝对数值变动），MEMS 晶圆制造毛利率为 16.24%，较上年下降 16.92%（绝对数值变动），上述变化的主要原因是：（1）本报告期 MEMS 业务收入（以人民币计算）整体与去年同期基本持平（其中 MEMS 晶圆制造业务收入显著下降，MEMS 工艺开发业务收入显著增长）；（2）本报告期 MEMS 业务成本较上年同期上升 25.21%，共同影响因素包括：欧洲供应链紧张程度加剧、欧元区通货膨胀高企，推高了原材料及人员成本，直接材料成本上升 6.22%；集团 2021 年限制性股票激励向境内外业务单元倾斜（超过 70%；其中 MEMS 业务在本报告期分摊的股权激励成本费用为 2,918.32 万元），带来额外的人工成本增加，共同导致直接人工成本大幅上升 68.32%；瑞典及北京 MEMS 产线均持续添购设备，本报告期 MEMS 业务端分摊的折旧规模达 3,464.26 万元，较上年同期增长了 32.80%，导致制造费用上升 14.23%；（3）随着公司境内外产能的进一步扩充，公司重视并持续开拓北美地区及中国境内潜力产品的战略性客户，在客户导入的不同阶段，销售策略作出一些调整，北美地区及中国境内在本报告期的毛利率均显著下降，尤其是中国境内下降了 41.28%，拉低了整体毛利率水平；（4）北京 FAB3 仍处于运营初期，实现收入规模较小，但折旧摊销压力巨大，工厂运转及人员费用大幅上升，其 MEMS 业务的综合毛利率为 5.48%，远低于瑞典产线，拉低了整体毛利率水平；（6）对于 MEMS 晶圆制造业务，由于原材料、人工、折旧等大额支出在收入中的占比扩大，以及境内外产线在晶圆制造方面的规模效应均未得到释放，最终导致了毛利率的大幅下降；（7）对于 MEMS 工艺开发业务，基于集团在当前阶段对 MEMS 工艺开发业务的侧重，各项投入激增，突出战略性考量，也最终呈现为毛利率的大幅下降。

报告期内，得益于 MEMS 应用市场的高景气度，并基于持续扩充的瑞典产线及北京产线，公司积极开拓全球市场，并积极承接生物医疗、通讯、工业汽车、消费电子等领域厂商的工艺开发及晶圆制造订单，继续服务全球 DNA/RNA 测序仪、光刻机、元宇宙、计算机网络及系统、硅光子、红外、可穿戴设备、新型医疗设备、汽车电子等巨头厂商以及细分行业的领先企业。

报告期内，公司瑞典 FAB1&FAB2 升级改造完成后的产能逐步磨合，其自身的 MEMS 工艺开发及晶圆制造业务的保障能力均得到加强；公司北京 FAB3 持续扩大覆盖不同的产品及客户，积极推进产能及良率爬坡，并进一步扩充产能。随着瑞典产线产能利用率的恢复提升，北京产线整体运营状态的持续提升，以及公司正在推进的其他产线布局，公司境内外同时拥有不同定位的合格产能，不同产线在产能、市场等方面的协同互补将有力保证公司继续保持纯 MEMS 代工的全球领先地位。

#### （二）GaN 业务持续布局投入

报告期内，公司 GaN 业务积极推进，在 GaN 外延材料方面，公司基于自身掌握的业界领先的 8 英寸硅基 GaN 外延与 6 英寸碳化硅基 GaN 外延生长技术，积极展开与下游全球知名晶圆制造厂商、半导体设备厂商、芯片设计公司以及高校、科研机构等的合作并进行交互验证，开始签订 GaN 外延晶圆的批量销售合同并陆续交付；在 GaN 芯片方面，公司已陆续研发、推出不同规格的功率芯片产品及应用方案，已推出数款 GaN 功率芯片产品并进入小批量试产，与知名电源、家电及通讯企业展开合作，进行芯片系统级验证和测试，开始签订 GaN 芯片的批量销售合同并陆续交付，并寻求长期稳定的产业链合作伙伴。

报告期内，公司持续布局 GaN 产业链，以参股方式建设 GaN 芯片制造产线，积极推动技术、工艺、产品积累，以满足下一代功率与微波电子芯片对于大尺寸、高质量、高一一致性、高可靠性 GaN 外延材料以及 GaN 芯片的需求，努力为 5G 通讯、云计算、新型消费电子、智能白电、新能源汽车等领域提供核心部件的材料保障及芯片配套。

#### （三）原有业务剥离

近年来，公司剥离了全部航空电子业务以及大部分导航业务，公司自 2022 年第二季度起不再从事惯性导航业务。

#### （四）研发情况

公司一直重视技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障。公司 MEMS 及 GaN 业务均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，需要公司进行重点、持续的研发投入。近年来，公司一直保持着较高的研发投入水平和强度，2019-2021 年，公司研发费用分别达 1.10 亿元、1.95 亿元、2.66 亿元，占营业收入的比重分别为 15.39%、25.54%、28.69%。报告期内，结合半导体业务长远发展的需要，公司大力推进 MEMS 工艺开发技术、MEMS 晶圆制造技术、GaN 材料生长工艺技术、GaN 器件及应用设计技术等研发，2022 上半年共计投入研发费用 13,908.94 万元，占营业收入的 36.85%，研发投入规模和强度呈现出极高的水平。具体详见本节“四、主营业务分析”之“研发投入情况”的相关内容。

#### （五）投融资情况

报告期内，为更好地服务于主业发展，公司根据长期发展战略继续积极开展投融资活动：（1）业务剥离方面，延续发展战略重大调整、资源聚焦半导体业务的需要，公司继续剥离剩余部分导航业务；（2）股权调整方面，积极推动重点业务子公司的架构调整及股权融资、转让所持中科昊芯股权；（3）新增投资方面，根据发展需要投资参股依迈微、青岛展诚；（4）产业基金方面，公司继续跟踪半导体产业基金、北斗产业基金的投资与投后情况，继续关注赛微私募基金的运行情况；（5）融资租赁方面，瑞典 Sillex 与赛莱克斯北京继续执行相关融资租赁交易。

报告期内，公司共实现投资收益合计 7,400.33 万元，其中处置长期股权投资的投资收益 7,809.78 万元，权益法核算的长期股权投资-409.44 万元。具体明细如下：

单位：万元

<b>投资收益总额</b>	7,400.33
<b>投资处置收益</b>	7,809.78
其中：	
北京中科昊芯科技有限公司	6,191.94
北京耐威时代科技有限公司	1,209.52
青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）	408.32
<b>持有股权收益</b>	-409.44
其中：	
湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	51.02
广州联星科技有限公司	-14.94
北京思丰可科技有限公司	-17.57
北京赛微私募基金管理有限公司	-89.78

武汉光谷信息技术股份有限公司	-338.16
----------------	---------

#### （六）整体发展战略

自成立以来，公司以传感终端应用为起点，通过内生发展及外延并购成功将业务向产业链上游延伸拓展，且 MEMS 工艺开发及晶圆制造已成为公司的主要业务。基于对 MEMS 与 GaN 产业发展前景的判断，且受囿于复杂的国际政治经济环境，公司对长期发展战略作出重大调整，陆续剥离非半导体业务，集中资源，形成以半导体为核心的业务格局，MEMS、GaN 成为分处不同发展阶段、聚焦发展的战略性业务。与此同时，公司围绕主要业务开展了一系列产业投资布局，直接或通过产业基金对产业链相关企业进行参股型投资。公司的发展目标是致力于成为一家立足本土、国际化发展的知名半导体科技企业集团。